

Calitech Co., Ltd
瑞耘科技股份有限公司(6532)

2026 Q3 法人說明會

2026.08.31



瑞耘科技股份有限公司
Calitech Co., Ltd.

E-mail: sales@calitech.com.tw
Web: www.calitech.com.tw

1

- Quality Engineering, Manufacturing &
Services Are Our Commitments

簡報大綱

- I. 公司簡介
- II. 產業結構**vs**產品組合
- III. 經營實績
- IV. **2026**營運概況及展望

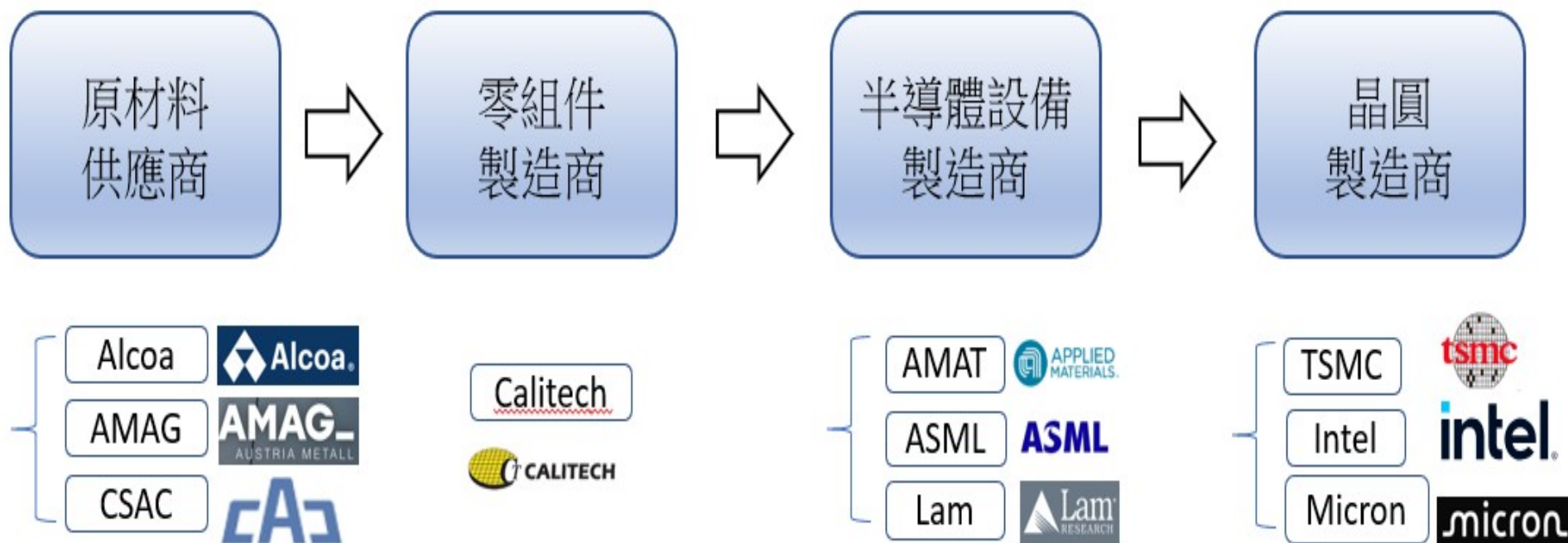


公司簡介

- 成立時間：1998年
- 實收資本額：新台幣3億7仟4佰萬元
- 董事長：呂學恒
- 總經理：呂學恒
- 員工人數：150人
- 主要產品：半導體前段製程設備零組件



產業結構暨瑞耘定位



產品組合



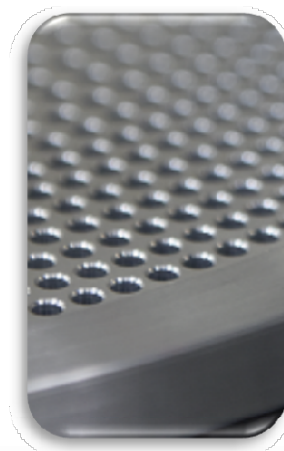
Retainer Ring
Outer Ring
Inner Ring

(CMP Process)



Clamp Ring
Deposition Ring
Focus Ring
Edge Ring

(PVD Process)
(Etching Process)



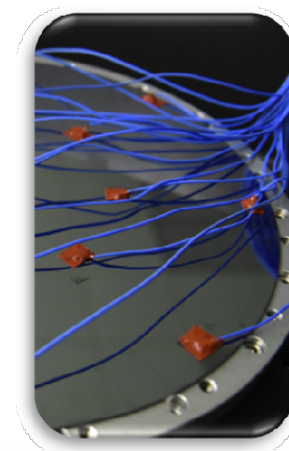
Shower Head
Face Plate
Blocker Plate
GDP

(CVD Process)
(ALD Process)
(Etching Process)



Chamber Coating
Chamber Lid
Chamber Liner
Confinement Ring

(ALD Process)
(PVD Process)
(CVD Process)
(Etching Process)



E-Chuck
Heater
Electrode

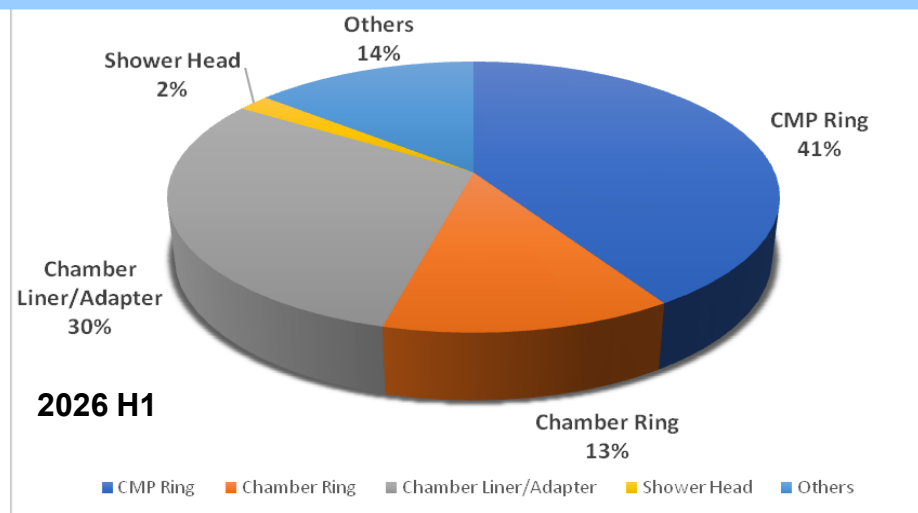
(Vacuum Chamber)



瑞耘科技股份有限公司
CaliTECH CO., LTD.

E-mail: sales@calitech.com.tw
Web: www.calitech.com.tw

產品組合 - 營收占比



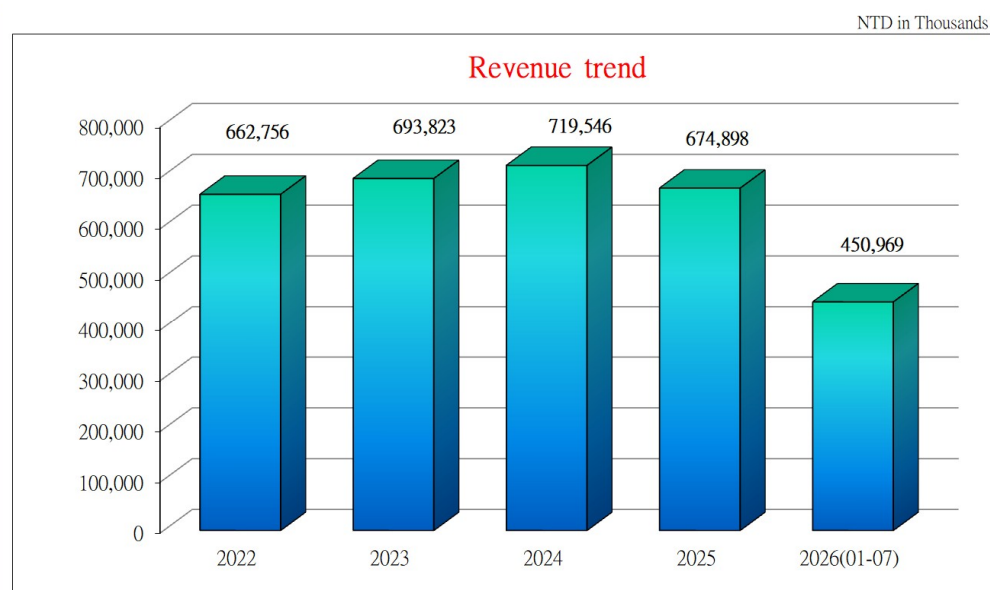
Product Group	Parts
CMP Ring (化學機械平坦化保持環)	• Retainer Ring (保持環) • Inner Ring (內環) / Outer Ring (外環)
Chamber Ring (腔體環)	• Clamp Ring (壓緊環/晶圓固定環) • Focus Ring (聚焦環/集焦環)
Chamber Liner/Adaptor (腔體內襯/轉接器)	• Liner(腔體內襯) • Shield (腔室屏蔽/遮罩)
Shower Head (氣體分配盤/勻氣盤)	• Face Plate (氣體分配盤－面盤) • Blocker Plate (氣體分配盤－阻隔盤)
Others (其它)	• Screw/Cover /Cap/Plug (螺絲、墊片、間格環...等配件) • Washer/Spacer/Shim



經營實績

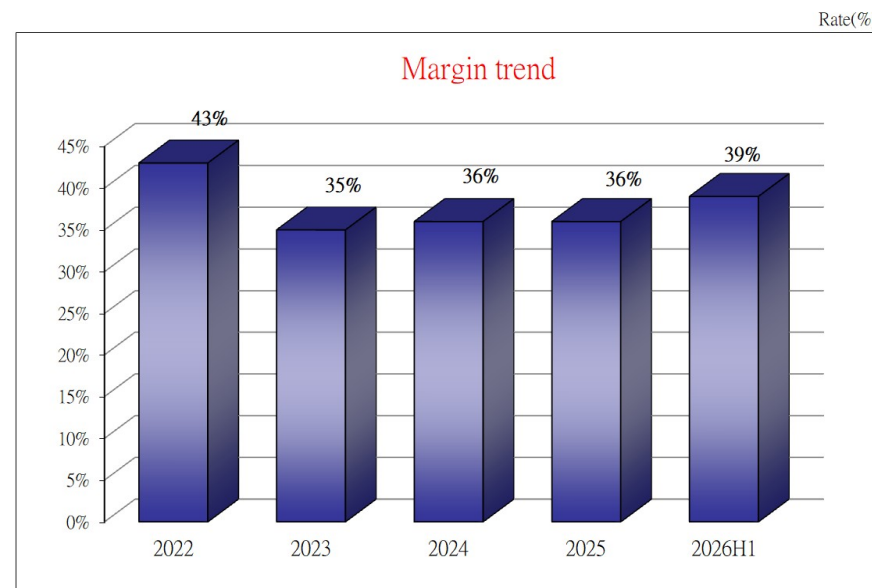
最近年度合併營收及毛利率

2022年～2026年01~07月營收



	2022	2023	2024	2025	2026(01-07)
Revenue	662,756	693,823	719,546	674,898	450,969
YOY(%)	31%	5%	4%	-6%	9%

2022年～2026H1 毛利



	2022	2023	2024	2025	2026H1
GP(%)	43%	35%	36%	36%	39%



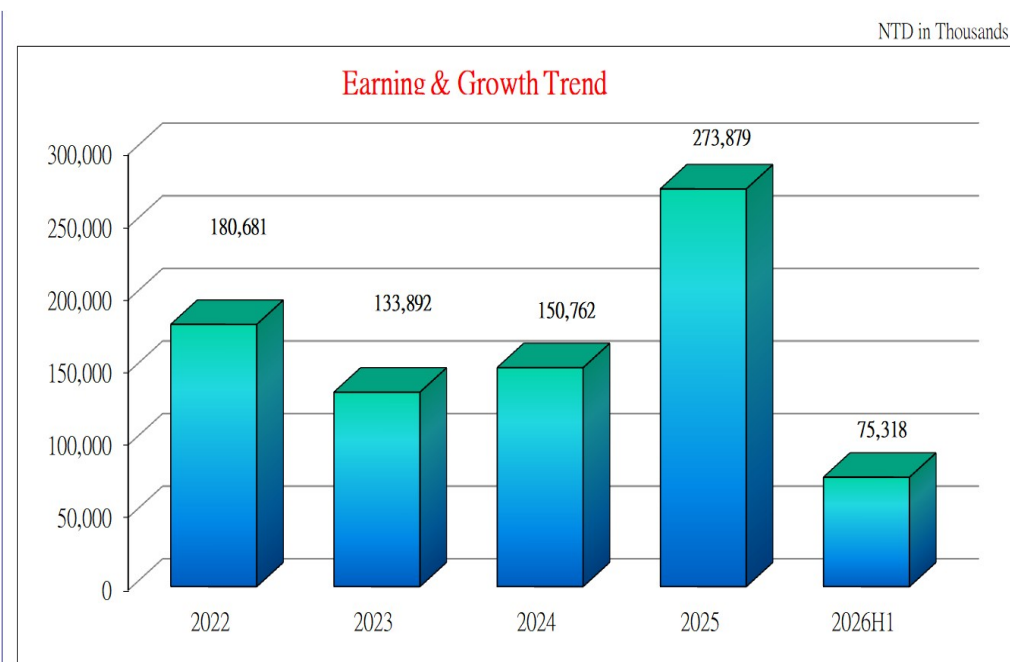
瑞耘科技股份有限公司
CaliTECH CO., LTD.

E-mail: sales@calitech.com.tw
Web: www.calitech.com.tw

經營實績

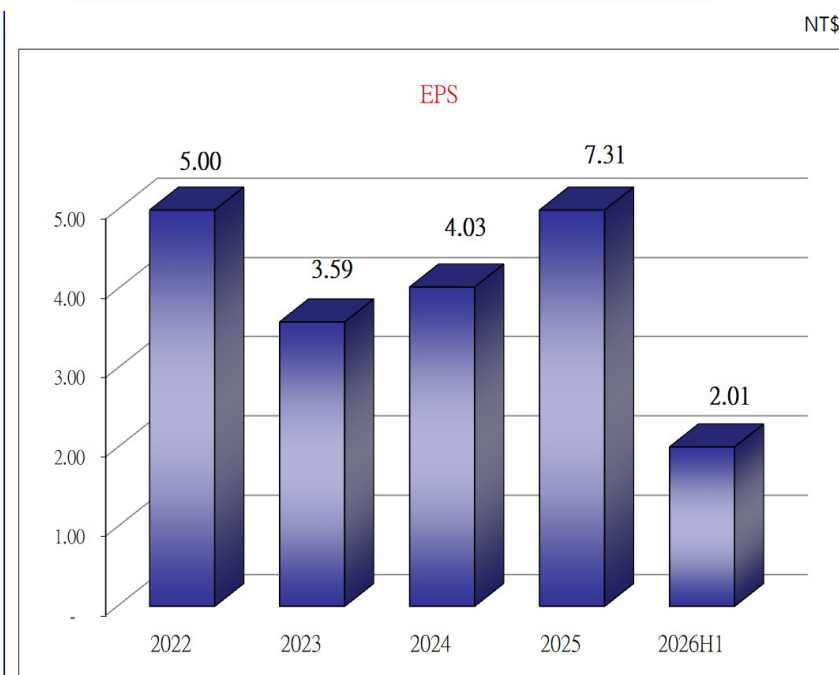
最近年度合併稅後純益及每股盈餘

2022年~2026年H1稅後淨利



	2022	2023	2024	2025	2026H1
Net Profit	180,681	133,892	150,762	273,879	75,318
YOY(%)	90%	-26%	13%	82%	57%

2022年~2026年H1 EPS



	2022	2023	2024	2025	2026H1
EPS	5.00	3.59	4.03	7.31	2.01



綜合損益表

單位:新台幣仟元

綜合損益表項目	2Q26		1Q26		季增率		2Q25		年增率	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	207,257	100	155,737	100	51,520	33	163,313	100	43,944	27
營業毛利	85,436	41	57,514	37	27,922	49	49,144	30	36,292	74
營業利益	58,579	28	32,790	21	25,789	79	32,502	20	26,077	80
營業外收支	1,955	1	6,403	4	(4,448)	(69)	(30,922)	(19)	32,877	106
稅前淨利	60,534	29	39,193	25	21,341	54	1,580	1	58,954	3,731
本期淨利	43,966	21	31,352	20	12,614	40	(245)	0	44,211	18,045
每股盈餘(新台幣元)	1.17		0.84		0.33	39	(0.01)		1.18	11,800



資產負債表

單位:新台幣仟元

資產負債表項目	2026年6月30日		2025年12月31日		2025年6月30日	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	445,938	27	162,797	10	287,594	22
應收帳款	150,312	9	130,759	8	116,397	9
其他應收款	4,827	0	288,940	19	2,208	0
存貨	197,115	12	135,098	9	122,647	9
不動產、廠房及設備	770,833	47	754,515	48	724,032	56
其他	83,934	5	95,277	6	47,544	4
資產總計	1,652,959	100	1,567,386	100	1,300,422	100
流動負債	412,611	25	291,305	19	270,094	21
非流動負債	4,419	0	2,895	0	1,004	0
負債總計	417,030	25	294,200	19	271,098	21
權益總計	1,235,929	75	1,273,186	81	1,029,324	79
負債總計/權益總計	1,652,959	100	1,567,386	100	1,300,422	100



現金流量表

單位:新台幣仟元

現金流量表項目	2026年H1	2025年H1
營業活動之現金流量	69,173	92,311
投資活動之現金流量	265,604	(19,667)
籌資活動之現金流量	(50,596)	(533)
匯率變動影響	(1,040)	(10,719)
現金增(減)數	283,141	61,392
現金及約當現金	445,938	287,594



2026 H1營運概況

■ 業績表現

2026/01~07 營收YoY 9 %

–2026年全球半導體製造設備銷售額預估將達1,659億美元，較2025年成長23.2%，創下歷史新高。主要動能來自於日本、歐洲與台灣的產能擴建工程，全球多座新晶圓廠預計下半年進入設備安裝期，確保了設備訂單能見度達2028年。半導體設備客戶加速且加倍關鍵零組件物料的下單備料。

■ 營運概況

–台灣總部：

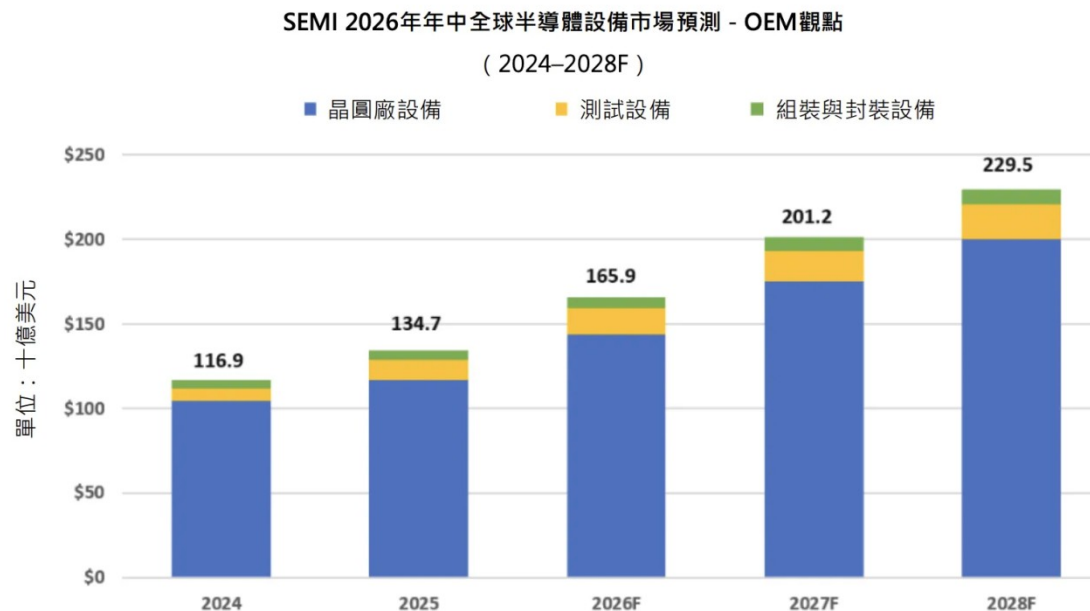
1. 產能已全部滿載，為因應客戶備料需求大增，已陸續招募人員以及添購新生產設備，加速訂單去化。
2. 依目前在手訂單以及客戶提供未來需求資訊，今年業績應能順利達成，且超越2025年。

–馬來西亞廠：

1. 機械加工以及化學清洗線相關設備已如期完成安裝，美系客戶現地稽核作業持續進行，預計2026年Q4完成客戶現地稽核，馬來西亞子公司取得合格供應商資格後，可直接接單出貨給客戶。
2. 馬來西亞廠取得獨立接單生產出貨資格後，也將逐步建立當地新產品開發能量，針對全球半導體設備大廠近年來於東南亞地區加大布局，可發揮鄰近客戶優勢，爭取更多的新商機。



市場發展動能 - 全球晶片製造商持續擴大設備支出



資料來源：SEMI 設備市場資料庫 (EMDS) · 2026年7月

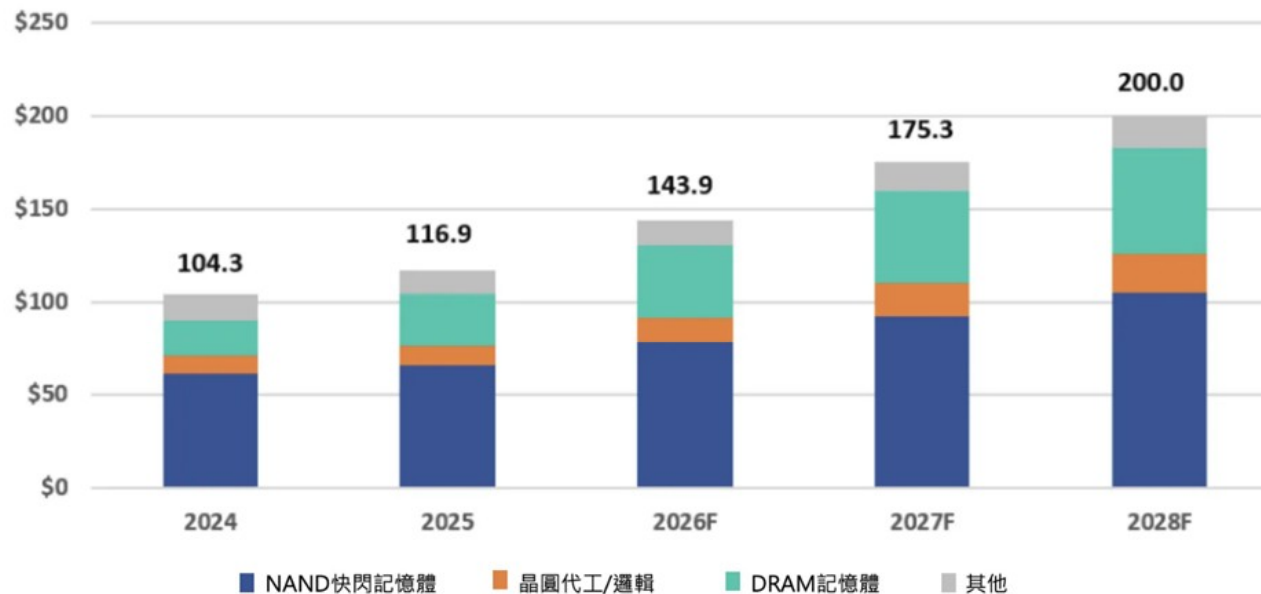
* 總設備市場包含新晶圓廠設備、測試設備及組裝與封裝設備，但不包含晶圓製造設備。

2026年全球半導體製造設備銷售額預估將達1,659億美元，較2025年成長23.2%，創下歷史新高。在AI需求持續驅動下，全球半導體製造投資動能可望延續至2028年，設備銷售額預計將攀升至2,295億美元，創下連續五年成長的新紀錄。



市場發展動能 – GAA以及HBM製程推進帶動WFE需求

SEMI 2026年年中晶圓廠設備市場預測 - 依應用別分類
(2024-2028F)



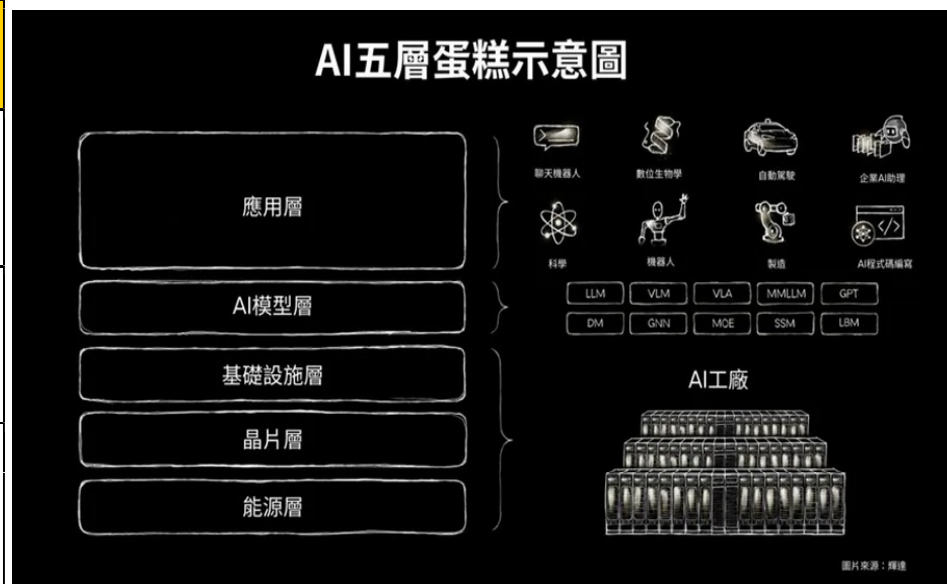
資料來源：SEMI 設備市場資料庫 (EMDS) · 2026年7月

涵蓋晶圓製程設備、光罩／光罩版（Mask/Reticle）設備及晶圓廠設施設備的全球前段製程設備（Wafer Fab Equipment, WFE），2025年銷售額創下1,169億美元新高，預估2026年將再成長23.1%，達1,439億美元。主要受惠於先進記憶體、尤其是HBM相關DRAM技術，以及先進邏輯應用投資持續增加。隨著製造商因應AI應用需求，加速擴充產能及推進技術升級，前段製程設備市場預估2027年及2028年將分別成長21.8%及14.1%，2028年市場規模可望突破2,000億美元。



市場發展動能 - AI is a 5 layer cake - NVIDIA

NVIDIA AI 五層蛋糕	涵蓋內容	NVIDIA AI 生態系投資概況
第一層：能源	涵蓋資料中心用電、電源供應及儲能系統。	SB Energy：\$15 億美元 NVIDIA 提供 \$1,050 億美元 信用與殘值保證，直接進場蓋「AI 發電廠」
第二層：晶片	涵蓋 GPU、ASIC 與 HBM 等。	Lumentum / Coherent：共\$40 億美元 Marvell：\$20 億美元 Enfabrica：>\$9 億美元
第三層：基礎設施	涵蓋伺服器、資料中心建設、散熱系統、高速網路與電力輸送等系統。	CoreWeave：持股約 \$50 億美元 Nebius：\$20 億美元
第四層：模型	涵蓋語言、生物、化學、物理、醫療等多領域的開源與閉源模型。	OpenAI：\$300 億美元 xAI：戰略權益股東 獨角獸群：Anthropic、Cohere、Perplexity、Mistral、Runway 等參投
第五層：應用	涵蓋軟體、智慧醫療、藥物研發、自動駕駛、工業機器人與企業 AI 助理等。	Bright Machines：\$1.26 億美元 Weka：\$1.4 億美元



資料來源: 輝達

NVIDIA 針對AI 生態系已承諾投入超過USD\$45B，以及USD\$105信用與殘值保證蓋AI發電廠。



瑞耘科技股份有限公司
CallTECH CO., LTD.

E-mail: sales@calltech.com.tw
Web: www.calltech.com.tw

15

- Quality Engineering, Manufacturing & Services Are Our Commitments

2026 H2營運展望

1. 市場與技術驅動成長動能：

- 1-1. 目前全球半導體市場發展皆圍繞在AI相關應用，需求已從生成式AI往代理式AI、邊緣AI到實體AI快速發展。帶動高效能運算（HPC）、高階邏輯製程晶片與HBM記憶體需求持續攀升。
- 1-2. 在AI需求持續驅動下，全球半導體製造投資動能可望延續至2028年，設備銷售額預計將攀升至2,295億美元，創下連續五年成長的新紀錄。

2. 機會與風險：

2-1. 供應鏈交期延誤

受中東戰爭影響，部分物料交期大幅延長，恐影響設備製造商交期，可能直接導致Fab. 廠新建廠房的投產進度面臨延誤風險。

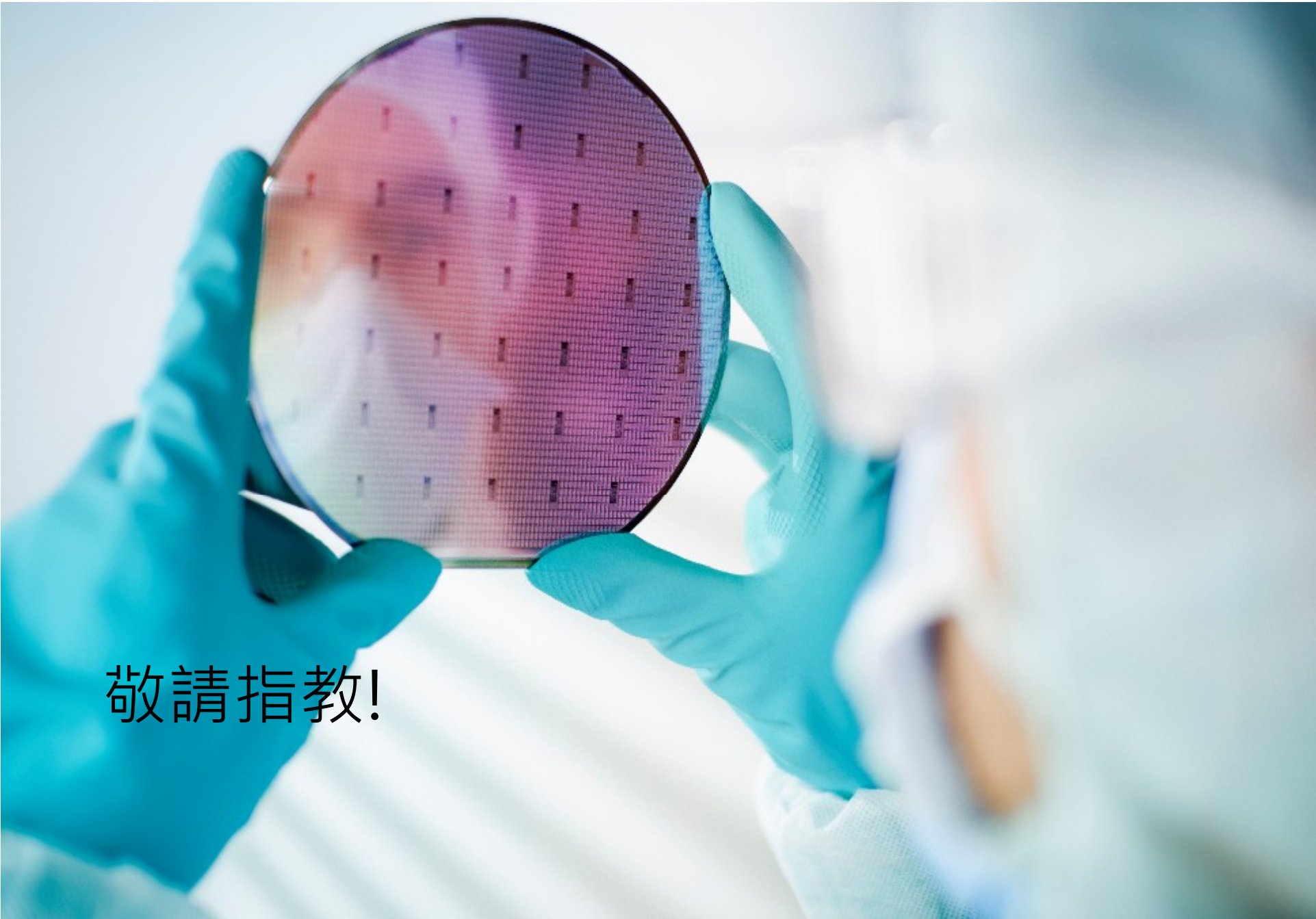
2-2. 地緣政治與出口管制升級

科技戰與出口限制風險未減，特別是在高階極紫外光（EUV）與先進沉積/蝕刻設備上，政策不確定性仍影響歐美半導體設備商在大陸市場的銷售比重與全球供應鏈的佈局策略。

2-3. 電力與能源基礎設施瓶頸

全球 AI 資料中心建置暴增，許多國家及地區面臨電力供給不足與電網瓶頸，若供電無法跟上 AI 伺服器的部署節奏，可能間接減緩AI相關建置的擴張速度。





敬請指教!



瑞耘科技股份有限公司
CaliTECH CO., LTD.

E-mail: sales@calitech.com.tw
Web: www.calitech.com.tw